星载缝隙波导微波天线热控方案研究与验证

施哲栋¹,毛云杰²,景海涛²,曾凡健¹,翟载腾¹,腊 栋¹,王 江¹,黄卫东² (1.上海卫星工程研究所,上海 201109;2.上海航天技术研究院,上海 201109)

摘 要: 微波天线阵面的热变形是影响在轨指向精度的关键因素,如何解决大功率器件的散热问题至关重要。 某微波天线热耗峰值近万瓦,在近20m²的全阵面内,需要保证收发(TR)组件的温升和补偿加热器的功耗不能过 高。针对某微波天线特有的工作模式和外热流情况,提出了机械泵驱动流体回路(MPFL)、双面散热和相变热管 3种热控方案,并分析了各自的特点和适用性。为解决天线内部狭小空间的辐射传导耦合问题,开展了单模块热阻 实验分析与优化,并得到了在轨测试的验证。

关键词:微波天线;热阻试验;热控方案;大热耗散热;相变热管;在轨实验
中图分类号:V45 文献标志码:A
DOI: 10.19328/j.cnki.2096-8655.2022.04.020

Research and Verification of Thermal Control Schemes for Spaceborne Slot Waveguide Microwave Antennas

SHI Zhedong¹, MAO Yunjie², JING Haitai², ZENG Fanjian¹, ZHAI Zaiteng¹, LA Dong¹,

WANG Jiang¹, HUANG Weidong²

(1.Shanghai Institute of Satellite Engineering, Shanghai 201109, China;

2.Shanghai Institute of Aerospace Technology, Shanghai 201109, China)

Abstract: The thermal deformation of microwave antenna array is the key factor affecting the pointing accuracy in orbit, and how to solve the heat dissipation problem of high-power devices is of vital importance. The peak heat consumption of a microwave antenna is nearly 10 000 W. In the full array area of about 20 m², it is necessary to ensure that the temperature rise of the transmitter and receiver (TR) module and the power consumption of the compensation heater are not too high. In view of the special working mode and external heat flow of a microwave antenna, three thermal control schemes, i.e., mechanically pumped fluid loop, double-sided heat dissipation, and phase change heat pipe, are proposed, and their characteristics and applicability are analyzed. In order to solve the problem of radiation and conduction coupling in the narrow space inside the antenna, thermal resistance tests are carried out for the analysis and optimization of single modules. The results show that the three proposed schemes are effective.

Key words: microwave antenna; thermal resistance test; thermal control scheme; large heat dissipation; phase change heat pipe; test in orbit

0 引言

微波天线具备全天时、全天候、高分辨率和宽 幅对地观测的优势,被广泛应用于资源勘测、地形 测量和洋流监测等领域^[1-2]。某星载微波天线采用 多方位多通道成像体制,多通道幅相不一致性不 仅会使图像产生虚假目标,而且会使径向运动目 标的虚假目标信号更强,甚至无法有效成像。文 献[3]认为解决元器件高热流密度下的散热难题 已经成为相控阵雷达的瓶颈问题。文献[4]从规 划传导热阻和风冷对流换热2种渠道仿真优化了 收发(Transmitter and Receiver, TR)组件的均温 性。文献[5]提出了应用平板热管、智能热控涂层 和基于环路热管(Loop Heat Pipe, LHP)的展开式 辐射器等方法解决微波天线万瓦级热耗排散的设 想。缝隙波导天线效率高、性能稳定、交叉极化

收稿日期:2021-02-08;修回日期:2021-04-17

作者简介:施哲栋(1993一),男,硕士研究生,主要研究方向为航天器热控技术。

低,文献[6-7]制备的表面铝光亮阳极氧化热控涂层, 吸收率和发射率精度可达0.01。文献[8]针对具有凹 槽和缝隙的复杂波导表面等效发射率进行了理论推 导、仿真建模和实验测量,认为三者结果基本一致。

本文针对某星载微波天线的在轨环境、结构布局和工作模式,选择缝隙波导对地面作为主散热面^[11-12]。通过对多种方案的比较,采取了相变热管的热控方案来控制天线温度范围和一致性。通过仿真分析了热阻与天线加热器补偿热耗的关系与 热阻实验的必要性,并通过热阻实验优化了天线内部的热阻分布情况,并通过了在轨测试的验证。

1 微波天线热控方案比较

某星载微波天线波导面直接对地,通过碳纤维 框架和展开机构完成支撑和固定。模块内安装 TR 组件和延时放大组件等器件,模块外安装功分器、二 次电源和波控单元等器件。微波天线热控的主要任 务是在满足重量和补偿功耗的前提下,控制天线在 轨双侧视下阵面内单机温度的波动范围和一致性。

1.1 机械泵驱动流体回路

机械泵驱动流体回路(Mechanically Pumped Fluid Loop, MPFL)能够高效地收集并排散热量,特 别适用于大热耗空间站的主动控温。通过冷板吸收 大热耗单机的热量,泵驱动工质循环带走热量,工质 流经辐射器时排散热量。MPFL成功地应用于美国 国家航空航天局(National Aeronautics and Space Administration, NASA) 月球车和欧洲航天局(European Space Agency, ESA)的 Alphabus 通讯卫星, 但 应用于微波天线的案例较少,主要存在以下弊端: 1) MPFL 在国内属于新技术领域, 各项关键指标仍 在确定,可靠性需要在轨数据的支撑;2) 微波天线的 主要任务是定标成像,对天线形变精度要求很高,流 体回路在不影响载荷精度的前提下安装布局难度较 大;3) 微波天线+Z面长期对地外热流稳定,一般作 为主散热面,如果流体回路的辐射器安装在天线上, 会干扰天线发射与接收信号,如果安装在载荷舱上, 又需要考虑载荷平台热控的耦合问题;4)流体回路 包含泵、储液器、温控阀、辐射器、冷板和控制单机, 重量一般较大,严重挤占微波天线的资源。

1.2 双面散热

双面散热方案主要是基于天线散热面局限问题提出的方案,传统微波天线只把+Z对地面作为

唯一散热面, -Z面包裹多层隔热组件。双面散热 方案取消了-Z面多层隔热组件,在波导背面增加 了卫星散热面,在某些特定轨道可以提升卫星的散 热能力。但某微波天线的-Z面外热流环境复杂, 双面散热方案存在以下弊端:1)光照期时阳光长期 直照,天线如果在光照期开机,相比+Z面散热不仅 不能增加天线散热能力,反而因为灌入热量而温度 升高;2)阴影期时相比+Z面散热增加了散热面, 用于维持天线温度的补偿加热器热耗上涨;3)由于 -Z面没有多层隔热,星体表面与天线的红外辐射 相互影响,不同位置TR的辐照环境不同,导致阵面 TR组件的温度一致性变差。

针对双面散热导致阵面 TR组件的温度一致性 变差的弊端,进行了 Thermal Desk 软件建模仿真, 热模型如图1所示。结果显示,+X侧天线由于星 体表面与天线-Z面的多重反射,靠近星体的 TR 组件温度更高,如图2所示。两侧天线的温差达到 了40℃,严重超出了的温度一致性指标。该现象是 由于在轨星体与天线的相对辐照关系实时变化引 起的,热控难度极大。



图 1 卫星有限元热模型 Fig. 1 Finite element thermal model for satellites





1.3 相变热管

相变储能十分契合微波天线空间狭小的使用 环境,同时在常规铝氨热管基础上研制的相变热管 解决了温度一致性难题。针对无人机微波天线发 热量大和安装空间狭小特点,文献[13]采用热管散 热器配合风机组件的方式散热。针对相控阵雷达 导引头内TR短时高热流散热的问题,文献[14]认 为可以使用增大系统质量或者相变储能的方法。 文献[15]认为提高相变材料的导热系数和装置的 翅片数能够降低热源安装面的温度。文献[16]针 对相控阵天线热耗变化模式,采用了液冷+相变储 能的快速切换热控方法。

某星载微波天线全阵面 TR 组件均匀分布在 120个一体化模块上,由于没有有源安装板,无法在 模块间安装预埋长热管。同时由于热控质量指标 的限制,无法采用增加散热面的方式存储高热流, 可以采用蓄热材料进行热控。相变材料较金属材 料更具质量优势,但存在液体形态,所以力学性能 不佳^[17],在热管中填充相变工质可以解决此类结构 可靠性的问题。相变微型热管配合贴在热管上的 加热器回路,实现低温工况的热量补偿和控制全阵 面 TR 组件的温度一致性。

微波天线使用相变热管前后的温度比较如图3 所示。天线在第10分钟开始工作,天线温度在相同 的启动温度-5℃附近开始升温。第17分钟相变材 料开始融化吸收热量,由于融化潜热显著大于显 热,在相变作用下天线升温速度明显下降。在相变 材料的吸热作用下,天线最的高温降低了10℃。



图3 使用相变热管前后的温度比较

Fig. 3 Temperature comparison before and after using the phase change heat pipe

综上,最终的热控方案采用相变热管,具体为: 大功率TR组件下方安装双孔铝氨-正十六烷相变 微型热管,一方面利用高能质比的相变潜热储存瞬 间高热流,抑制TR组件工作时的温升;另一方面配 合加热器回路实现全阵面单机均温化控制。阵面 内单机间安装间隙有限,单机表面采用镀金和黑色 阳极氧化的方法改善单机间的辐射换热,结构安装 板采用局部喷涂E51-M黑漆改善单机与波导间的 辐射换热。阵面内产生的大热耗通过缝隙波导对 地面辐射出去,其余面包裹导电型F46薄膜镀银二 次表面镜多层隔热组件。

2 单模块热阻实验研究

2.1 实验必要性分析

微波天线内部单机结构复杂,需要热阻实验评 估传导热阻。文献[9]通过规划TR组件与冷板之 间的接触热阻和传导热阻,控制了相控阵天线TR 组件的最高温和均温性。一般卫星微波天线的模 块组件安装在有源板上(例如高分三号卫星¹⁰⁰),有 源板与波导间隔着碳纤维框架,有源板和框架导热 性很差,所以导热热阻极大,完全被辐射热阻旁路, 没有做热阻测试的必要性。而某星载微波天线一 体化天线模块内组件直接安装在天线波导背面,其 中安装脚通过螺钉与结构板金属连接,组件上的连 接器直插在波导内,之间导热热阻较小,导致组件 与波导间的温差较小。因此加热器的功耗有一部 分传导到波导上,波导温度也随之升高,需要更多 的热控功耗来控制组件的温度。热阻模式的差异 如图4所示。



Fig. 4 Differences in the thermal resistance patterns



续图 4 热阻模式的差异 Continued fig. 4 Differences in the thermal resistance



导热热阻直接影响温度指标和热控功耗指标, 需要对温度和热控功耗进行敏感度分析,如图5和 图6所示。通过分析可知,热阻的不确定度会造成 13℃的温度变化和400W的热控功耗偏差。





2.2 实验原理及方法

一体化天线模块+Z面朝上,平卧在实验台架上,天线-Z面包多层隔热组件,模块与实验台架之间间距 300 mm,用环氧玻璃布棒(直径 15 mm)支撑,一端与模块螺纹连接,另一端配安装脚站立在实验台架上,每个安装脚用 M8螺栓现场配打固定。 支撑杆外包覆 15 层多层隔热组件,并粘贴测温热电 偶监测支撑杆的温度,如图 7 所示。天线结构件和 部件上粘贴测温热电偶以获得温度分布。天线对 地面(+Z面)用加热器模拟外热流,多层表面外热



consumption with the thermal conduction resistance

流粘贴加热器模拟。一体化天线模块模拟件热源 加热器、热控控温加热器、外热流模拟加热器分别 通过转接电缆连到真空罐外,用程控电源和软件进 行控制;测温热电偶通过电缆和接插件连到真空罐 外,用地面设备进行采集并通过计算机显示。





Fig. 7 Schematic diagram for tests within the KM 1.5 vacuum tank (profile map)

2.3 实验件状态分析

实验件共3个模块,热控状态对比见表1。相对 于模块1,模块2减小了热管、延时放大组件、功分器 与结构板间的辐射,消除了热管安装脚与波导的导 热,但增加了BMA盲插件的导热。相对于模块1, 模块3增大了波导发射率。

2.4 实验结果分析

在每一个模块TR组件和延时放大组件上施加 每轨工作3、5、7和9min的一轨平均热耗,稳态温度 结果见表2。

表1 实验件的热控状态对比

Tab. 1 Comparison of the thermal control states of the test modules

项目	模块1	模块2	模块3
波导发射率	0.38	0.38	0.68
热管与波导接触	安装脚	无	安装脚
TR与热管接触	垫铟箔	垫铟箔	垫铟箔
热管表面涂层	黑漆	本色	黑漆
热管下方结构板涂层	黑漆	镀铝膜	黑漆
延时放大器下方结构板涂层	黑漆	镀铝膜	黑漆
TR盲插件	无	有	无
功分器表面涂层	黑漆	导电氧化	黑漆

表 2 温差实验结果(℃) Tab. 2 Results of the difference in temperature (℃)

实验件	指标	3 min	5 min	7 min	9 min
模块1	TR	-27.3	-20.7	-14.9	-6.7
	热管	-27.3	-20.8	-15.0	-6.8
	结构板	-30.8	-26.3	-22.3	-16.6
	功分	-30.9	-26.3	-22.2	-16.4
	延时	-29.1	-23.3	-19.3	-14.0
	热管到结构板温差	3.5	5.5	7.3	9.8
	延时到结构板温差	1.7	3.0	3.0	2.6
模块2	TR	-25.9	-20.0	-14.6	-7.2
	热管	-25.6	-19.8	-14.5	-7.1
	结构板	-28.2	-23.6	-19.3	-13.7
	功分	-27.7	-23.0	-18.7	-13.1
	延时	-25.1	-18.7	-14.5	-9.2
	热管到结构板温差	2.6	3.8	4.8	6.6
	延时到结构板温差	3.1	4.9	4.8	4.5
模块3	TR	-19.9	-15.7	-10.1	-6.9
	热管	-19.5	-15.4	-9.9	-6.7
	结构板	-23.0	-20.8	-17.7	-16.0
	功分	-22.9	-20.5	-17.2	-15.4
	延时	-20.9	-17.4	-14.1	-12.7
	热管到结构板温差	3.5	5.4	7.8	9.3
	延时到结构板温差	2.1	3.4	3.6	3.3

从实验结果可知:

1)模块1和模块3内热管到结构板的温差和延
时到结构板温差基本一致,因为其内部热实施状态
完全一致,与波导表面涂层辐射属性无关。

2)比较模块1和模块2,模块1TR组件到结构 板的温差比模块2大40%~50%,模块1延时放大 组件到结构板的温差比模块2小40%左右。定性 分析,模块2内虽然热管与结构板不接触,而且表面 未喷漆,结构板相对位置还贴镀铝膜,但每排TR组 件安装了8个BMA接插件,因此导热增强,温差减 小;模块2的延时下方位置粘贴镀铝膜,因此辐射传 热被削弱,温差变大。

3)模块内功分器与结构板温度基本一致,主要因为功分器不发热,温度与安装面温度接近。

针对TR组件与结构板间的温差,经定量分析 其热阻见表3和图8。从热阻实验结果分析,整排 TR组件(含热管)到结构板的热阻偏小,原先设计 中TR组件到结构板的温差15.0℃,目前实验结果 为6.6℃,会导致需要更多的热控功耗来维持TR组 件-5.0℃启动。热阻偏小的原因有2点:①各安装 面间的接触热阻比预计的小;② BMA 接插件热阻 比预计的小。

表3 TR组件到结构板热阻对比

Tab. 3 Thermal resistance from the TR module to the structural slab

编号	传热路径	热阻/(C•W ⁻¹)
А	TR组件单个安装脚到结构板	119
В	单个 BMA 接插件	33
С	模块1整排TR(含热管)到结构板	5.41
D	模块2整排TR(含热管)到结构板	2.70



Fig. 8 Comparison of the thermal resistance from the TR module to the structural slab

模块2中热管与结构板不接触,没有导热,TR 组件总热阻为7.44 C/W,BMA 接插件总热阻为 4.13 C/W,2热阻并联后整排TR(含热管)到结构板 的总热阻为2.7 C/W,因此BMA 热阻占较大一部 分。增加BMA 热阻对减小功耗最明显。经分析, 在 BMA 接插件法兰安装面安装厚度为1 mm 玻璃 钢垫片后,热控补偿功耗减少了140 W,各单机温度 指标仍然满足要求,具体变化见表4。

表 4 方案变化前后的指标比较 Tab. 4 Comparison of different schemes

模式	组件名称	方案变化前	方案变化后
右侧视天线 工作9min/轨	TR组件/℃	$-3.7{\sim}20.6$	$-2.4{\sim}23.7$
	功分器/℃	$-4.2 \sim -2.5$	$-4.0 \sim -1.6$
	结构板/℃	$-5.4 \sim -0.3$	$-5.2 \sim -1.8$
右侧视天线不工作	TR组件/℃	-5.5	-5.0
	功分器/℃	-13.5	-18.1
	结构板/℃	-13.7	-18.5
热控功耗/W		800	660

3 微波天线在轨测试验证

在轨测试结果见表 5, 微波天线内部的器件温 度值满足指标要求, 相变热管能够有效地控制器件 温度, 热阻优化后的天线加热器补偿功耗符合预 期, 星载缝隙波导微波天线热控方案可行。

表 5 微波天线在轨测试温度 Tab. 5 Results of the heat balance tests in orbit

组件	高温	北扫滞日桂刀	
	最低温	最高温	111小俩足 111几
TR组件/℃	-5.8	20.0	满足
延时放大组件/℃	-4.9	6.7	满足
波导天线/℃	-4.7	0	满足
天线框架/℃	-23.3	6.5	满足
TR组件温升/℃	2	满足	
补偿加热器功耗/W	656		满足

4 结束语

本文针对某星载缝隙波导微波天线大阵面高热 耗下的热控需求,通过调研分析比较了MPFL、双面 散热和相变热管3种热控方案,通过热阻实验优化了 微波天线内部单机接触热阻方案。在轨测试结果表 明,星载缝隙波导微波天线热控方案合理可行。

参考文献

- [1]谢辉,赵强,曾祥能.合成孔径雷达技术应用于星载平 台的现状与发展[J].舰船电子对抗,2019,42(1):6-9.
- [2]陈宇,李钰,陈丽,等.卫星天线反射面板热形变面形误差检测方法[J].上海航天(中英文),2020,37(4): 117-127.
- [3] 平丽浩.雷达热控技术现状及发展方向[J].现代雷达, 2009,31(5):1-6.
- [4]常文凯,胡龙飞,贺奎尚,等.风冷有源相控阵天线热设 计[J].电子机械工程,2018,34(6):17-21.
- [5]守利,苏力争,钟剑锋.星载SAR天线热控技术现状及 发展趋势[J].电子机械工程,2013,29(6):6-13.
- [6]李春林,辛世刚.星载缝隙波导天线热控涂层的制备工 艺[J].电子机械工程,2016,32(1):40-43.
- [7] 吴晓霞,胡江华,卢海燕. 铝合金裂缝波导天线热控膜 制备技术[J].电子科技,2015,28(8):164-166.
- [8]张晶晶,曾凡健,王江,等.裂缝波导天线等效发射率计 算与测量方法[C]//第十二届空间热物理会议.北京: 中国宇航学会飞行器总体专业委员会,2015:514.
- [9] 常文, 胡龙飞, 贺奎尚, 等. 风冷有源相控阵天线热设计 [J]. 电子机械工程, 2018, 34(6):17-21.
- [10] 张传强,孟恒辉,耿利寅,等.星载平板有源 SAR 天线 热设计与验证[J].航天器工程,2017,26(6):99-105.
- [11] 关宏山.星载合成孔径雷达天线热控设计研究[J].雷达科学与技术,2007,5(6):427-430.
- [12] 倪勇,李建新,陈辉,等.星载 SAR 相控阵天线一体化 热设计[J].现代雷达,2016,38(4):60-63.
- [13] 刘晓红,崔二光.某无人机SAR天线系统的热设计[J]. 电子机械工程,2014,30(3):12-15.
- [14] 王虎军.弹载相控阵雷达导引头热控设计研究[J].机 械与电子,2018,36(6):37-40.
- [15]何智航.某弹载天线热管 PCM 热控装置参数分析[J]. 航天器环境工程,2019,36(1):33-39.
- [16] 郑雪晓.一种弹载相控阵天线多工况快速切换热控方 法[J].电讯技术,2014,54(4):513-517.
- [17] 朱尚龙,刘欣,刘小旭,等.基于铜蓄热的Ka频段相控 阵天线热控技术研究[J].载人航天,2018,24(2): 202-207.